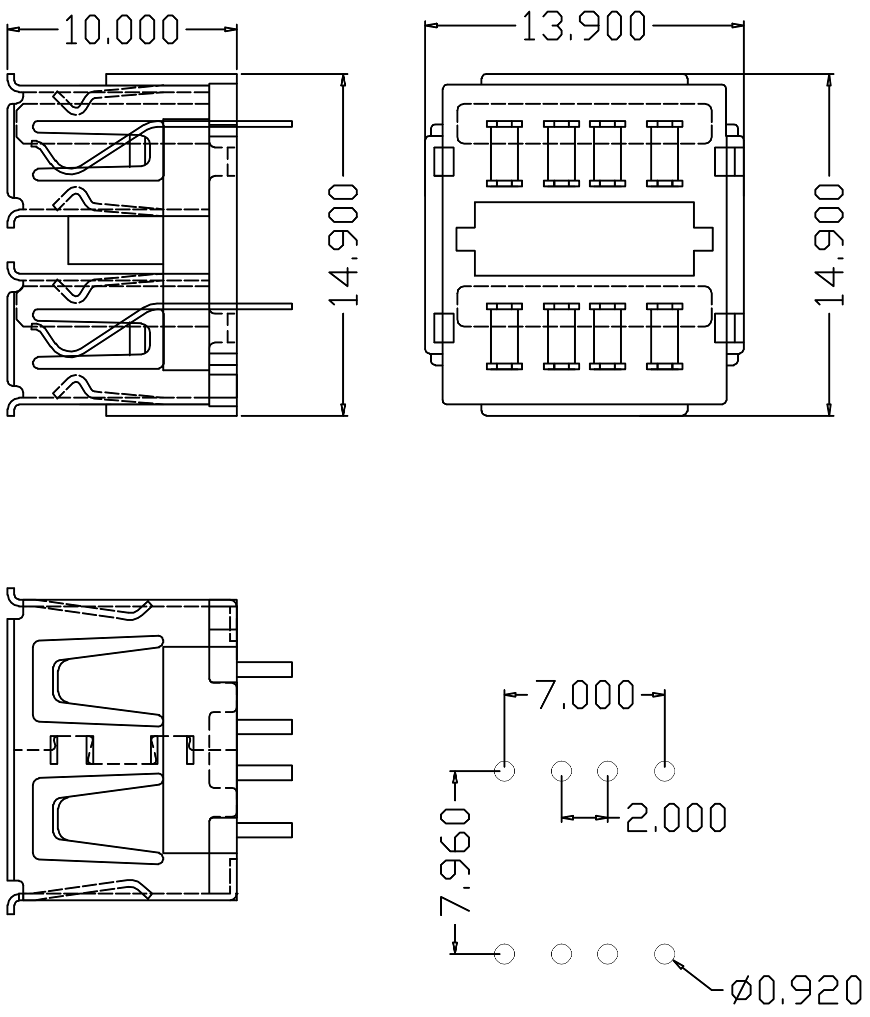
? ? Mapx	? ? ? ? Modification	? ? Date	??? Draw	? ? Approve
⚠1				



NOTES:
1. MATERIAL SPECIFCATION
1) INSULATION MATERIAL THERMOPLASTIC.
2) SHELL:COPPER ALLOY/SPCC, T:0.30mm
PLATING: NICKEL
3) TERMINAL:COPPER ALLOY, T:0.25mm
PLATING: GOLD/TIN PLATED.
2. ELECTRICAL CHARACTERISTIC:
1) INSULATION RESISTANCE:1000MΩ MIN.
2) CONTACT RESISTANCE:30mΩ MAX.
3) WITHSTANDING VOLTAGE:500V AC.
3. MECHANICAL CHARACTERISTICS:
1) INSERTION FORCE:3.57Kgf MAX.
2) EXTRACTION FORCE:1.02Kgf MIN.

ORDERING INFORMATION

A 02-D X X X X X 0 X-1063

包装方式区分码:
1:格子盒

胶芯颜色区分码:
0:黑色

胶芯材质区分码:
1:PBT
2:LCP

端子电镀区分码:
1:G/F 1U" 引脚亮锡

外壳电镀区分码:
1:NI≥60μ" 2:NI≥80μ"
3:NI≥100μ" 4:NI≥150μ"

外壳材质区分码:
1:Copper Alloy
2: SPCC

D:DIP

USB 2.0 F

A TYPE

成 品 图 MANUFACTURE DWG		深圳市虹康科技有限公司							
公 差 一 览 表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE									
.X±0.15	X.±5°	日 期 DATE	DATE	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAWING	DRAWING	图 号 DWG NO.	DWGNO.
.XX±0.05	.X±2°	核 CHECXED	CHECXED	比 例 SCALE	1 : 1	设 计 DESIGN	DESIGN	品 名 NAME	10.0A 母外壳
.XXX±0.02	.XX±1°	核 准 APPROVE	APPROVE	角 法 VIEW	⊕ ⊲			版 本 VER	VER | 页 数 SHEET | PG1